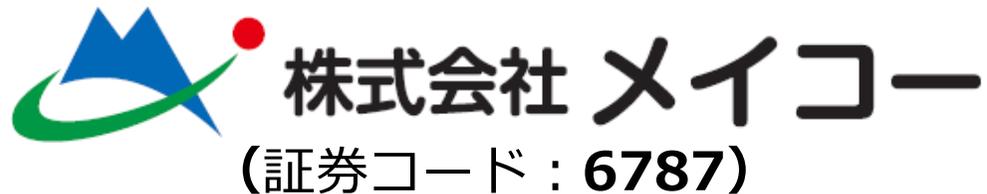


2024年3月期上期

決算説明会資料

2023年11月16日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

■ 業績報告

2024年3月期上期実績

■ 業績予想

2024年3月期下期予想

■ 新事業の状況

天童工場
石巻第2工場
ベトナム第3工場

2024年3月期上期 連結実績

(単位：億円)

	2023年3月期	2024年3月期	前年同期比	
	上期実績	上期実績	増減額	増減率
売上高	817	862	45	5.5%
営業利益	46	42	-4	-8.7%
	5.7%	4.9%		
経常利益	87	68	-19	-21.8%
	10.7%	7.8%		
当期純利益	64	52	-12	-18.8%
	7.9%	6.0%		
期中平均為替レート (JPY/USD)	135.31	142.61		
1株当たり配当金	27円	27円		

2024年3月期上期 商品別実績

(単位：億円)

	2023年3月期上期実績						2024年3月期上期実績					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	417	28 6.7%	13	0 0.0%	430	28 6.5%	452	28 6.2%	20	1 5.0%	472	29 6.1%
スマートフォン タブレット	142	7 4.9%			142	7 4.9%	115	4 3.5%			115	4 3.5%
半導体パッケージ	2	0 0.0%			2	0 0.0%	2	-4 -200.0%			2	-4 -200.0%
SSD IoTモジュール	48	7 14.6%			48	7 14.6%	36	4 11.1%			36	4 11.1%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	136	3 2.2%	59	1 1.7%	195	4 2.1%	109	6 5.5%	128	3 2.3%	237	9 3.8%
合計	745	45 6.0%	72	1 1.4%	817	46 5.7%	714	38 5.3%	148	4 2.7%	862	42 4.9%

■ 業績報告

2024年3月期上期実績

■ 業績予想

2024年3月期下期予想

■ 新事業の状況

天童工場
石巻第2工場
ベトナム第3工場

2024年3月期下期・通期 連結予想

(単位：億円)

	2024年3月期			予想修正差異	
	下期予想	通期予想	期初予想	増減額	増減率
売上高	868	1,730	1,650	80	4.8%
営業利益	58 6.7%	100 5.8%	90 5.5%	10	11.1%
経常利益	48 5.5%	116 6.7%	80 4.8%	36	45.0%
当期純利益	41 4.7%	93 5.4%	62 3.8%	31	50.0%
期中平均為替レート (JPY/USD)	135	138.80	130		
1株当たり配当金	28円	55円	50円		

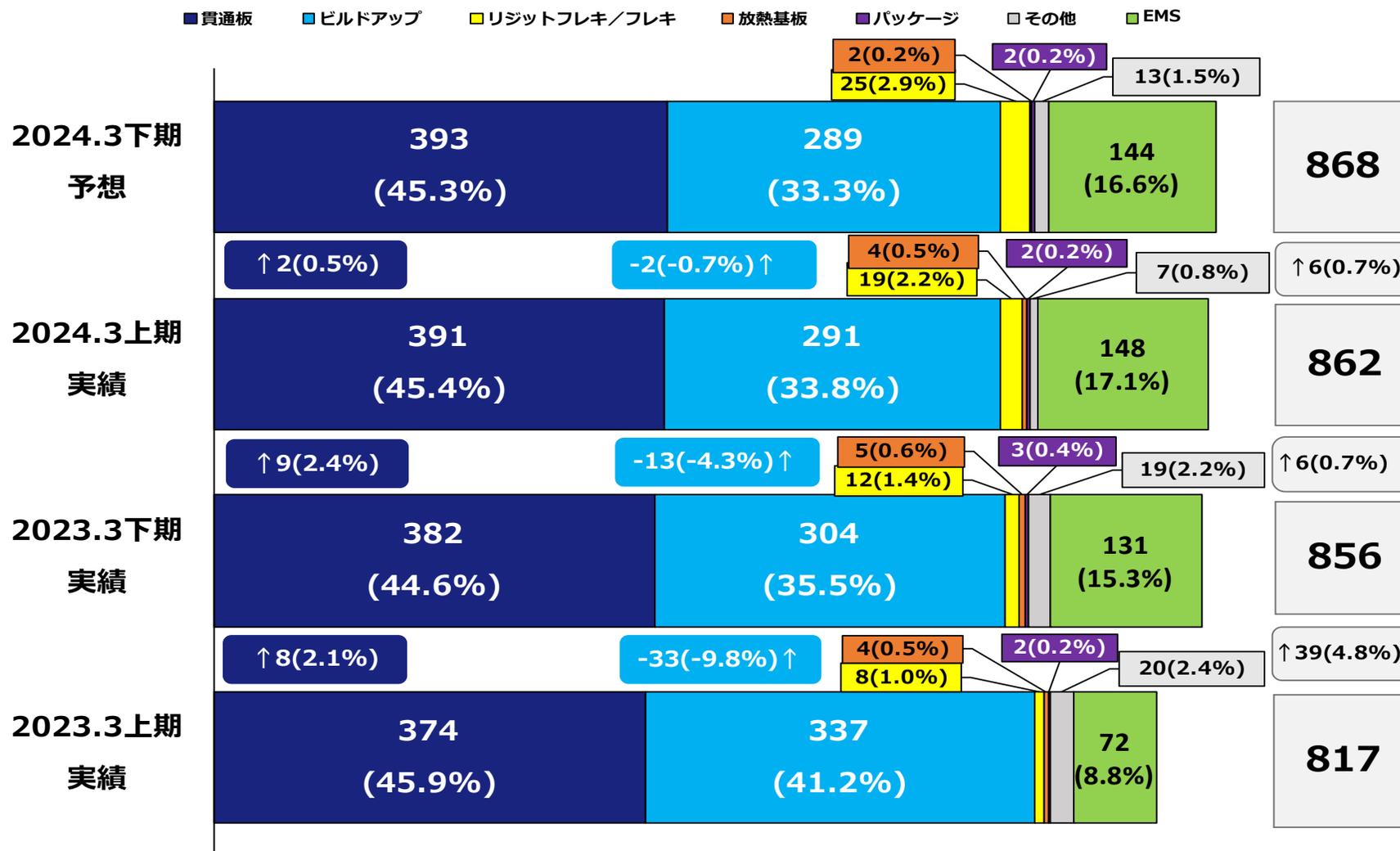
2024年3月期下期・通期 商品別予想

(単位：億円)

	2024年3月期下期予想						2024年3月期通期予想					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	455	35 7.7%	33	1 3.0%	488	36 7.4%	907	63 6.9%	53	2 3.8%	960	65 6.8%
スマートフォン タブレット	130	14 10.8%			130	14 10.8%	245	18 7.3%			245	18 7.3%
半導体パッケージ	2	-6 -300.0%			2	-6 -300.0%	4	-10 -250.0%			4	-10 -250.0%
SSD IoTモジュール	51	4 7.8%			51	4 7.8%	87	8 9.2%			87	8 9.2%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	86	6 7.0%	111	4 3.6%	197	10 5.1%	195	12 6.2%	239	7 2.9%	434	19 4.4%
合計	724	53 7.3%	144	5 3.5%	868	58 6.7%	1,438	91 6.3%	292	9 3.1%	1,730	100 5.8%

2024年3月期 仕様別上期実績/下期予想

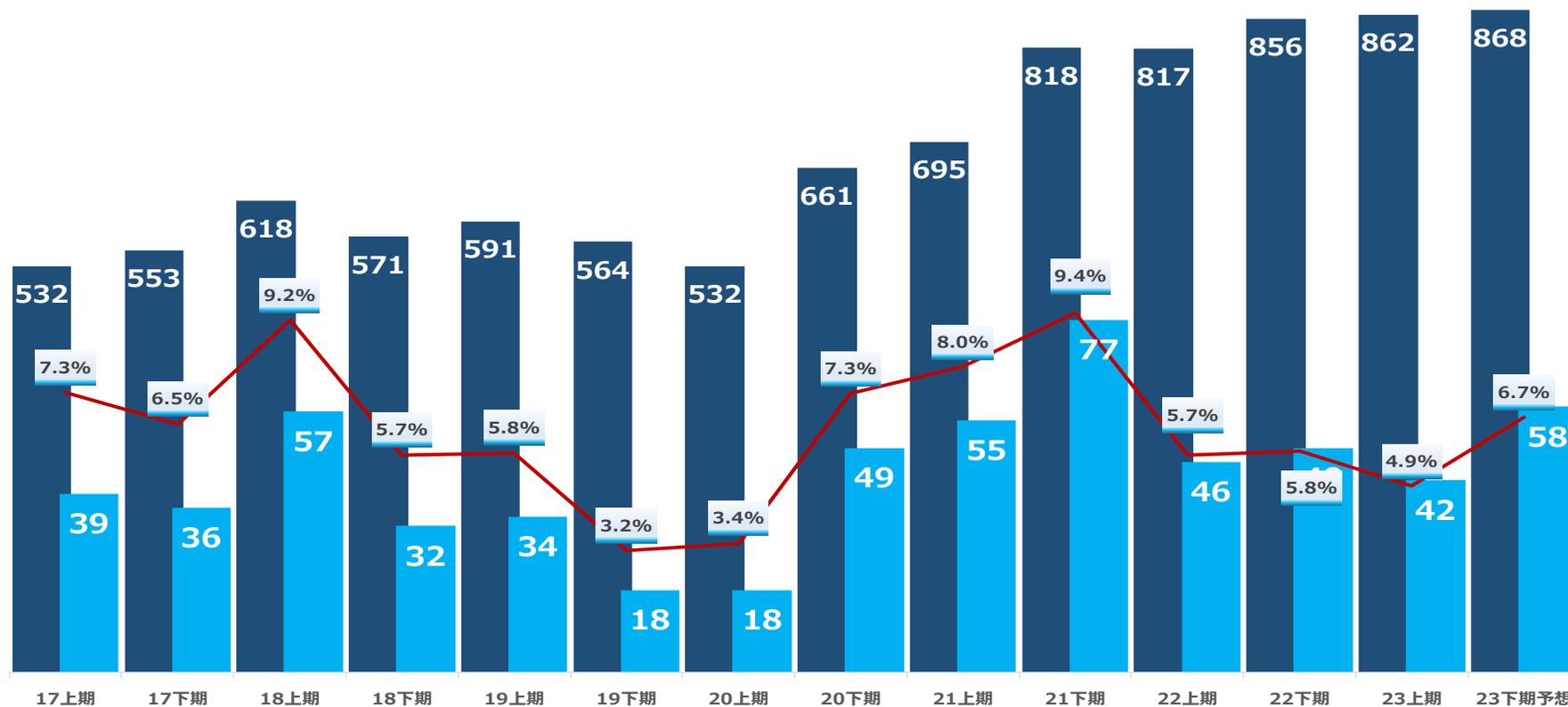
(単位：億円)



売上高・営業利益他推移

(単位：億円)

■売上高 ■営業利益 —利益率



投資額 (億円)	96	150	120	107	144	174	200
EBITDA (億円)	133	152	121	141	213	193	206
DEレシオ	1.4	1.7	2.0	1.7	1.1	0.9	0.8
自己資本比率	30.0%	27.8%	25.1%	28.6%	34.7%	38.2%	41.1%

■ 業績報告

2024年3月期上期実績

■ 業績予想

2024年3月期下期予想

■ 新事業の状況

天童工場
石巻第2工場
ベトナム第3工場

新事業の状況

2023年10月竣工



天童工場

石巻第2工場

ベトナム第3工場

生產品目

高密度ビルドアップ基板

FC-BGA基板

メモリーPKG基板

現在の状況

顧客認定が進行中

半導体市況により量産開始時期が遅延

量産開始時期

2024年4月

2024年10月

2024年4月

計画比

計画通り

計画比約1年遅れ

計画比約1年遅れ



エレクトロニクスの進化に挑戦し発展して社会に貢献する
Challenge the evolution of electronics and achieve development thus contribute to the society

